

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 新型电子元器件封装材料

请输入查询关键词

科技频道

搜索

新型电子元器件封装材料

关键词: **封装材料** **电子元器件**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段: 初期阶段

成果体现形式: 新材料

知识产权形式: 发明专利

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 上海工程技术大学

成果摘要:

本项目研制的材料,可用于电子元器件的封装,防潮,防湿,有较好的导热性能和尺寸稳定性。本实验选择重质CaCo₃,Al₂O₃,SiO₂,ZnO,以及A,B等作为封装材料的基础填料;树脂基体以环氧树脂为基础,同时考虑与其它树脂复合。测试不同种类填料及其用量,复合树脂的组成封装材料性能(体积电阻,导热率,吸水率和热膨胀率系数)的影响情况。有报道低温固化的封装材料,但都没有提供有关的性能指标;与高温固化的封装材料相比热膨胀系数有超过的倾向,在热传导率和体积电阻率方面有微小的差距,作为电子元器件的封装,应该是完全能够胜任的。室温下即可发生固化反应,固化速率适当,操作安全简便,性能接近或超过高温固化的封装材料。以其优良的性能为后盾进行推广应用,将会取得良好的经济效益。封装材料在室温下固化,可降低操作工人的劳动强度、工作环境和简化设备,具有一定的社会意义。

成果完成人: 甘文君;张燕;郑静

[完整信息](#)

行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库勒勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氢重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

成果交流

推荐成果

- [新型稀土功能材料](#) 04-23
- [低温风洞](#) 04-23
- [大型构件机器缝合复合材料的研制](#) 04-23
- [异型三维编织增减纱理论研究](#) 04-23
- [飞机炭刹车盘粘结修复技术研究](#) 04-23
- [直升飞机起动用高能量密封免...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场预应力混凝...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场30000立方米...](#) 04-23
- [高性能高分子多层复合材料](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布